

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2023-007

天水华天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	
传真	0938-8632260	0938-8632260	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。从全球市场来看，封装测试行业市场集中度较高且较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，近年来全球前十大企业市场份额达到 75%以上，而且有进一步提高的趋势。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

2022 年，全球半导体行业增速大幅放缓。一方面，由于地缘政治冲突、经济发展放缓等因素的影响，半导体市场终端消费动力不足；另一方面，半导体行业在经历高速增长，以及产能扩充达到一定程度后，逐渐进入了新的供需平衡阶段，部分环节出现去库存状况。根据美国半导体工业协会（SIA）统计，2022 年半导体销售额同比实现 3.2%的增长，达到 5,735 亿美元，但增幅较 2021 年的 26.2%回落明显。

在全球半导体市场增速放缓的背景下，消费类电子产品等终端需求受到较大冲击，我国集成电路产业规模同比出现负增长。根据国家统计局的数据显示，2022 年我国集成电路产量 3,241.9 亿块，同比下降 9.8%，这是自 2009 年以来首次出现下滑。从 2022 年各月产量来看，各月产量同比均出现下降，10 月份产量同比下降高达 26.7%。从终端产品来看，2022 年，我国手机产量 15.6 亿台，同比下降 6.2%；微型计算机产量 4.34 亿台，同比下降 8.3%。

2022 年，公司持续关注集成电路行业发展及市场需求情况，积极克服市场需求下降对封装订单的影响，不断提高客户服务能力和管理水平。2022 年，公司共完成集成电路封装量 419.19 亿只，同比下降 15.57%，晶圆级集成电路封装量 138.95 万片，同比下降 3.18%；完成营业收入 119.06 亿元，同比下降 1.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.54 亿元，同比下降 46.74%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	30,971,431,803.80	29,974,351,599.53	3.33%	19,309,122,269.13
归属于上市公司股东的净资产	15,789,099,171.17	15,049,446,789.13	4.91%	8,506,631,614.77
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	11,905,960,519.12	12,096,793,328.40	-1.58%	8,382,084,225.00
归属于上市公司股东的净利润	753,945,434.18	1,415,671,366.19	-46.74%	701,709,840.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,064,740.07	1,100,632,762.23	-76.01%	531,812,331.74
经营活动产生的现金流量净额	2,877,164,434.94	3,444,362,299.00	-16.47%	2,058,108,186.81
基本每股收益 (元/股)	0.2353	0.5025	-53.17%	0.2561
稀释每股收益 (元/股)	0.2353	0.5025	-53.17%	0.2561
加权平均净资产收益率	4.89%	14.04%	-9.15%	8.70%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,007,617,767.32	3,213,160,501.46	2,905,990,905.29	2,779,191,345.05
归属于上市公司股东的净利润	206,843,720.36	307,202,990.33	190,296,765.61	49,601,957.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,098,176.35	164,410,293.82	55,729,570.98	-104,173,301.08
经营活动产生的现金流量净额	386,104,975.27	939,399,744.20	969,960,013.64	581,699,701.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	340,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	329,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	---------------------	---------	-------------------	---	---------------------------	---

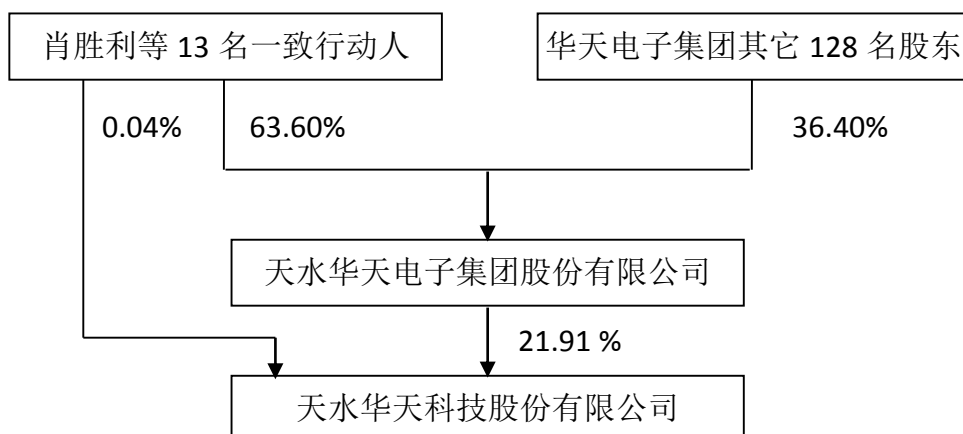
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	21.91%	701,974,542	0		
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.21%	102,914,400	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66%	53,278,169	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	52,287,394	0		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.13%	36,247,723	0		
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	31,056,466	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	30,754,587	0		
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	27,322,404	0		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	24,655,847	0		
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.67%	21,348,004	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，天水华天电子集团股份有限公司用于转融通出借业务所出借的 31,194,000 股公司股份于报告期内全部到期收回。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2022 年公司主要工作开展情况如下：

1、报告期内，公司持续关注客户订单需求及市场发展动态，在市场需求减弱、去库存等不利因素的情况下，公司及时调整销售策略，优化销售区域管理，聚焦客户需求，加强客户的沟通和拜访，大力开拓战略新客户，努力争取订单。同时，公司强化通过终端客户了解市场情况以及对封装测试服务的诉求，提升终端客户和市场对公司品牌的认可，全面高效服务客户，提升客户满意度。报告期内，公司导入客户 237 家，通过 6 家国内外汽车终端及汽车零部件企业审核，引入 42 家汽车电子客户，涉及 202 个汽车电子项目。大尺寸 FCBGA 高算力系列产品 and 高端存储产品均实现批量生产。

2、报告期内，公司持续加大研发投入，完成了 3D FO SiP 封装工艺平台、基于 TCB 工艺的 3D Memory 封装技术的开发；双面塑封技术、激光雷达产品完成工艺验证；基于 232 层 3D NAND Flash Wafer DP 工艺的存储器产品、长宽比达 7.7: 1 的侧面指纹、PAMiD 等产品均已实现量产；与客户合作开发 HBPOP 封装技术。

本年度公司共获得授权专利 69 项，其中发明专利 7 项。

3、对标行业标杆，开展设备最佳实践和效率提升痛点识别，进行信息化及自动化建设，以信息化、自动化推动生产高效化。持续通过 IATF16949 及 ISO9001 等体系审核，继续开展“精益六西格玛”改进质量能力建设，总结公司汽车电子专线、重点客户专线“零客诉、零赔偿、零退货”的质量管控方法，建立由质量联合销售、生产、技术等多部门协同进行质量过程设计和管理体系，以专线管理促进公司整体质量水平提升。

4、公司根据集成电路市场发展及客户需求情况，推进募集资金投资项目及韶华科技等新生产基地建设。在募集资金投资项目方面，各募集资金投资项目顺利实施，截至报告期末，已使用募集资金 43.28 亿元。在新生产基地建设方面，韶华科技已完成一期厂房及配套设施建设，并于 2022 年 8 月投产；华天江苏积极开展项目建设的各项准备工作；Unisem Gopeng 项目正在进行厂房建设。上述项目和新生产基地的建设和投产，为公司进一步扩大产业规模提供发展空间。

5、报告期内启动了客户服务流程、采购流程、财经流程、质量管理流程等业务流程变革，继续推进实施客户与销售流程、技术研发流程、生产制造流程、数据治理体系建设等流程变革项目，识别生产制造业务痛点并进行改善，完成 CRM 系统各模块功能测试与优化，搭建客户主数据管理 CRM 系统，不断推进 OneMES520、SRM、PDM 等 IT 项目建设。持续关注创新焦点和关键业务举措，推动公司运营管控体系建设，加快推进公司数字化转型，稳步提升公司管理能力和运营效率。

6、公司积极开展安全生产工作，保障了员工的身体健康与生命安全。通过开展管控措施细化、执行及稽查督导等工作，强化季度安环会议警示教育意义，严抓 EHS 体系建设及有效运行，全面落实安全生产责任制。公司获得了“国家级绿色工厂”、“天水市消防安全管理先进单位”、“特种设备使用先进单位”等称号。